



# 第1四半期連結決算の概要

---

取締役執行役員 原田 芳輝

2012年7月30日

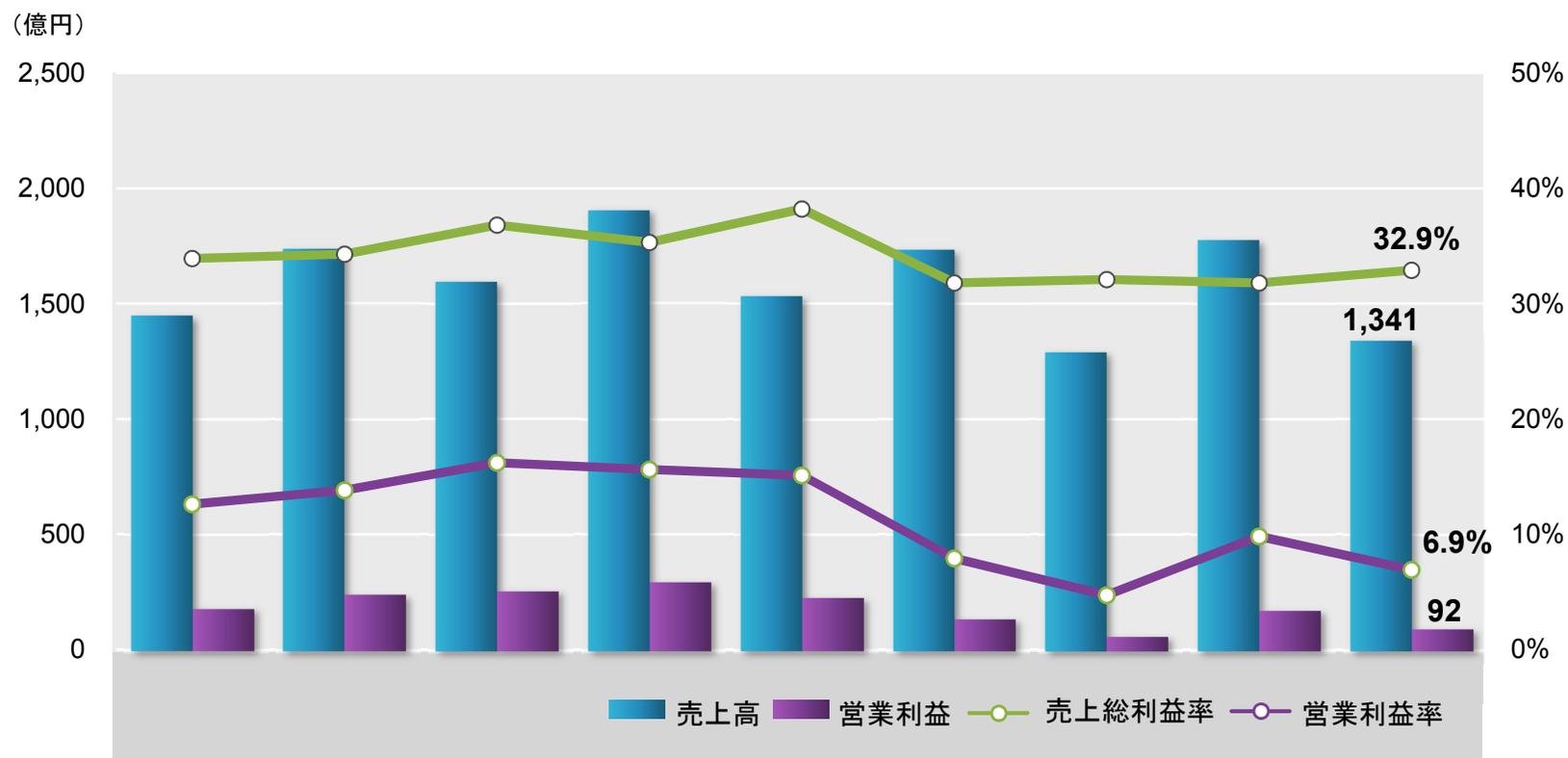
# 損益状況

(億円)

|                   | 2012年3月期       |                |                |                | 2013年3月期       |         |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                   | 1Q             | 2Q             | 3Q             | 4Q             | 1Q             | 対前年1Q増減 |
| 売上高               | 1,531          | 1,732          | 1,291          | 1,775          | 1,341          | -12.4%  |
| SPE               | 1,208          | 1,275          | 915            | 1,378          | 1,087          | -10.0%  |
| FPD/PVE           | 125            | 241            | 166            | 165            | 47             | -62.0%  |
| EC/CN             | 196            | 213            | 208            | 229            | 206            | +4.9%   |
| その他               | 0              | 1              | 0              | 1              | 1              | +5.2%   |
| 売上総利益             | 584<br>(38.2%) | 550<br>(31.8%) | 414<br>(32.1%) | 564<br>(31.8%) | 441<br>(32.9%) | -24.6%  |
| 販管費               | 353            | 413            | 353            | 389            | 348            | -1.6%   |
| 営業利益              | 230<br>(15.1%) | 137<br>(7.9%)  | 60<br>(4.7%)   | 174<br>(9.8%)  | 92<br>(6.9%)   | -59.8%  |
| 税前利益              | 234            | 158            | 67             | 146            | 112            | -52.0%  |
| 当期純利益             | 166            | 100            | 7              | 93             | 57             | -65.6%  |
| 1株当たり<br>当期純利益(円) | 92.91          | 55.95          | 4.21           | 51.98          | 31.93          | -65.6%  |
| 研究開発費             | 181            | 229            | 187            | 216            | 179            | -1.4%   |
| 設備投資額             | 59             | 166            | 76             | 93             | 76             | +29.2%  |
| 減価償却実施額           | 47             | 57             | 64             | 71             | 55             | +17.7%  |

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: FPD製造装置/太陽光パネル製造装置, EC/CN: 電子部品/情報通信機器
2. ( )内は利益率
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

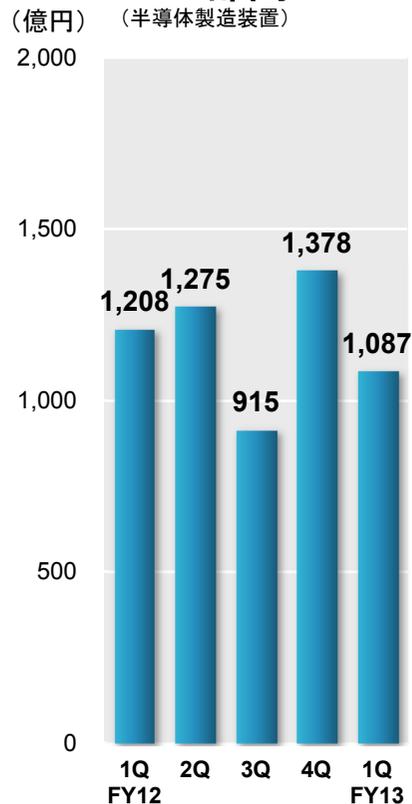
# 売上高・営業利益・利益率推移



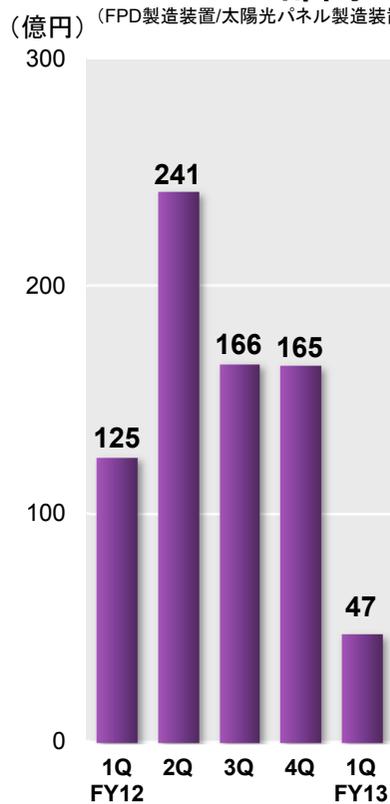
|        | FY11/1Q | 2Q    | 3Q    | 4Q    | FY12/1Q | 2Q    | 3Q    | 4Q    | FY13/1Q |
|--------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 売上高    | 1,448   | 1,735 | 1,596 | 1,906 | 1,531   | 1,732 | 1,291 | 1,775 | 1,341   |
| 営業利益   | 183     | 240   | 258   | 297   | 230     | 137   | 60    | 174   | 92      |
| 売上総利益率 | 33.9%   | 34.3% | 36.8% | 35.3% | 38.2%   | 31.8% | 32.1% | 31.8% | 32.9%   |
| 営業利益率  | 12.6%   | 13.8% | 16.2% | 15.6% | 15.1%   | 7.9%  | 4.7%  | 9.8%  | 6.9%    |

# 部門別売上高

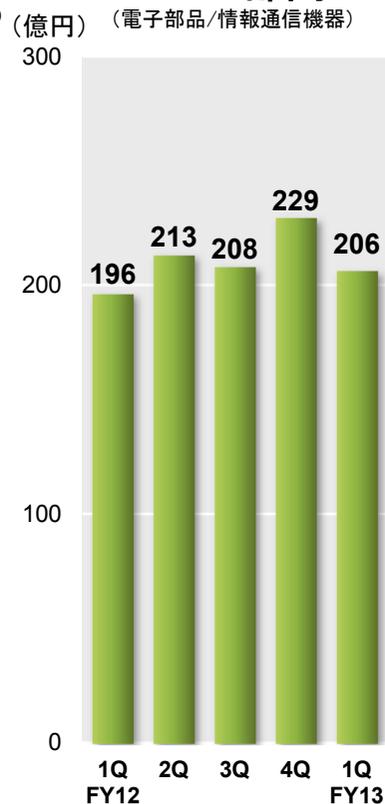
**SPE部門**  
(半導体製造装置)



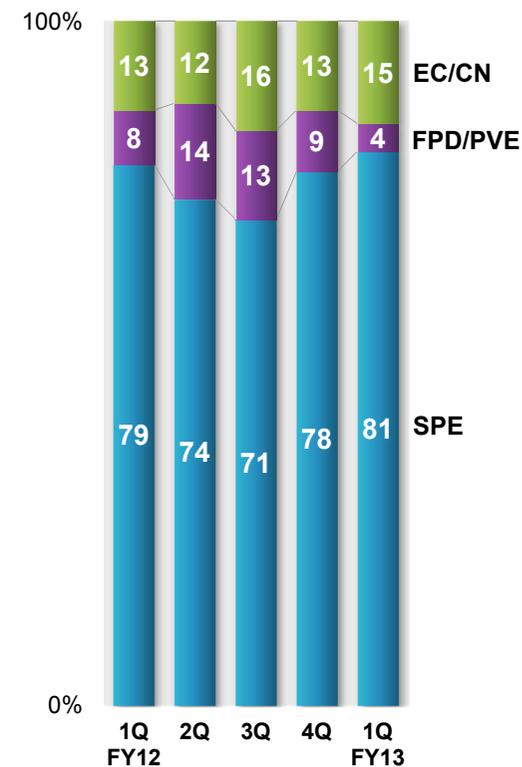
**FPD/PVE部門**  
(FPD製造装置/太陽光パネル製造装置)



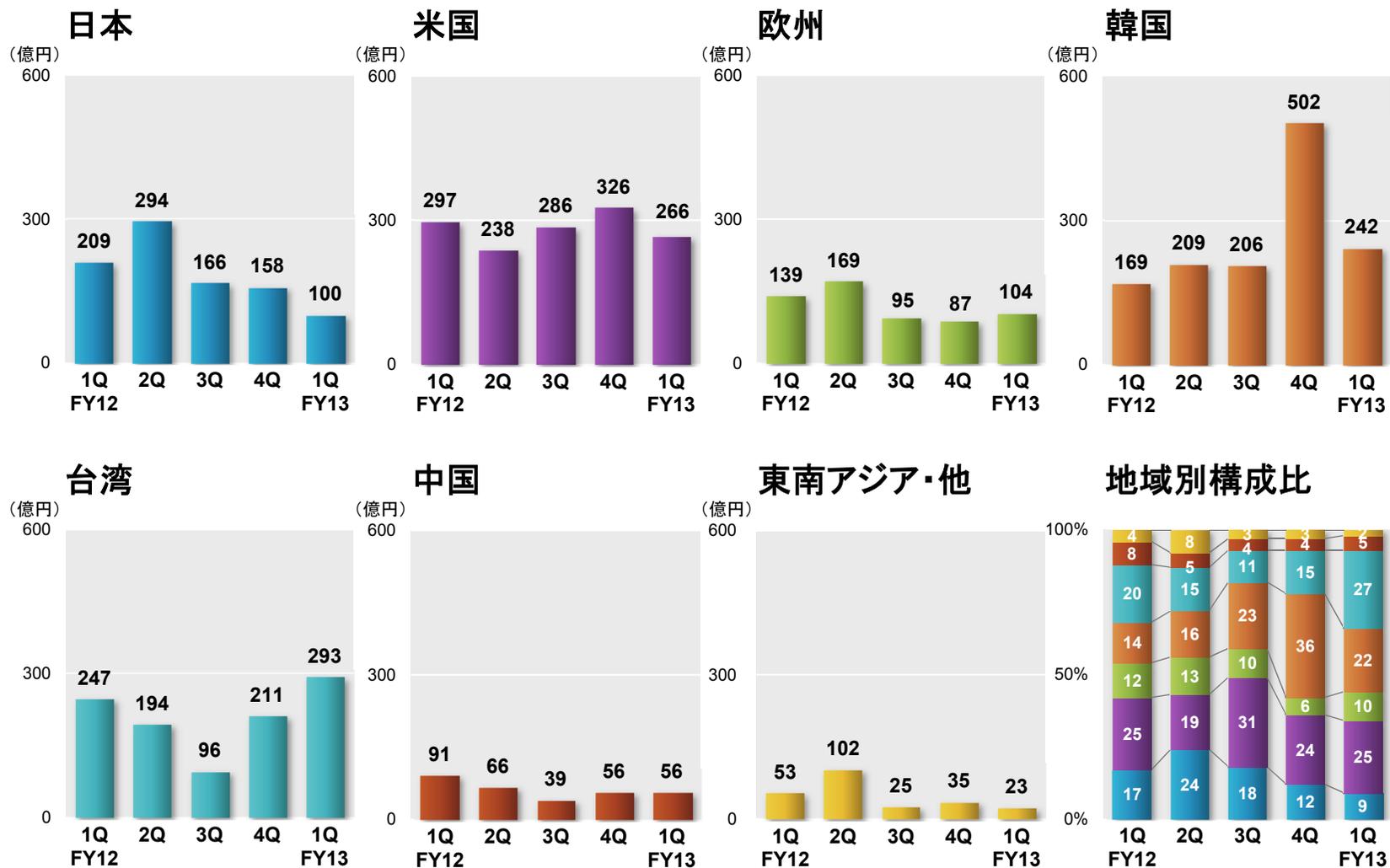
**EC/CN部門**  
(電子部品/情報通信機器)



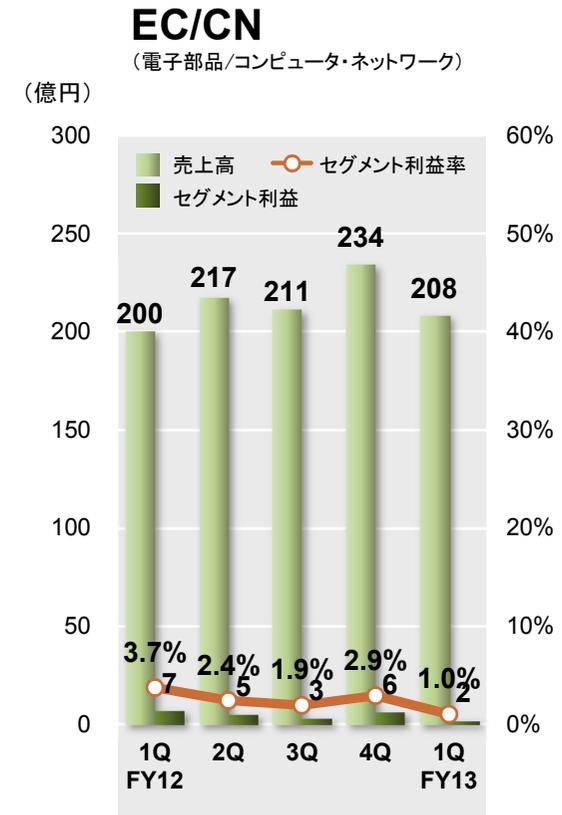
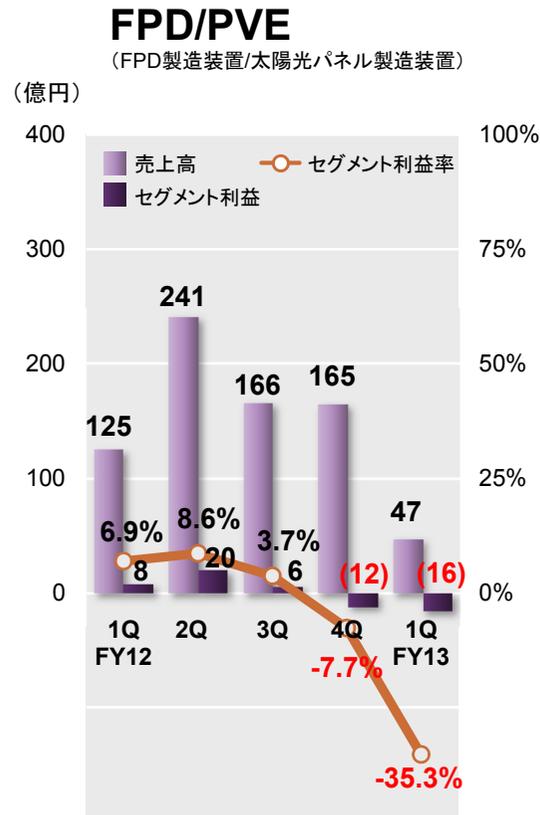
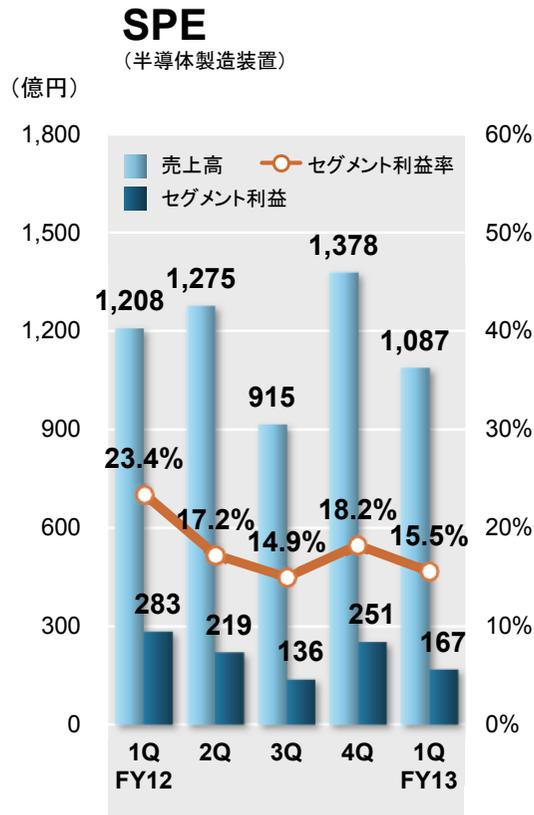
**部門別構成比**



# SPE部門地域別売上高

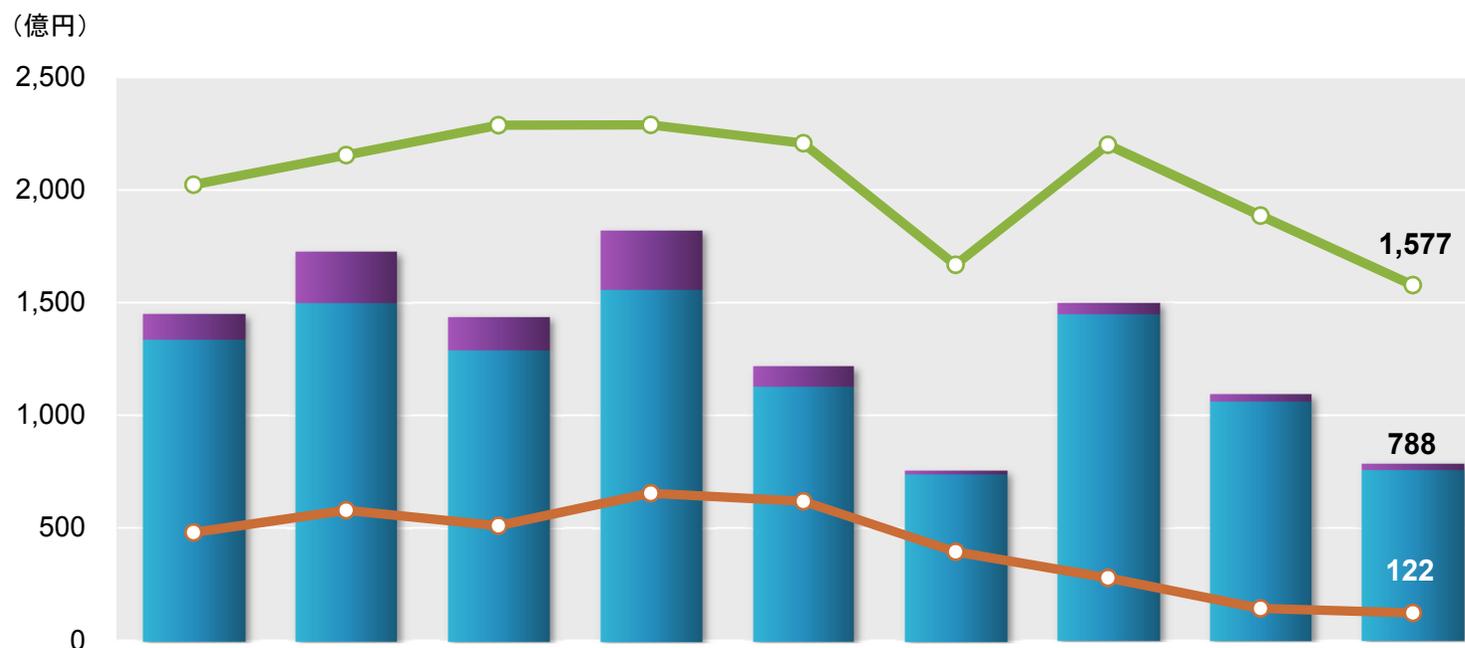


# セグメント情報



1. 上記報告セグメントには、基礎研究又は要素研究等の研究開発費が含まれておりません。
2. セグメント利益は、税前利益をベースとしています。
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

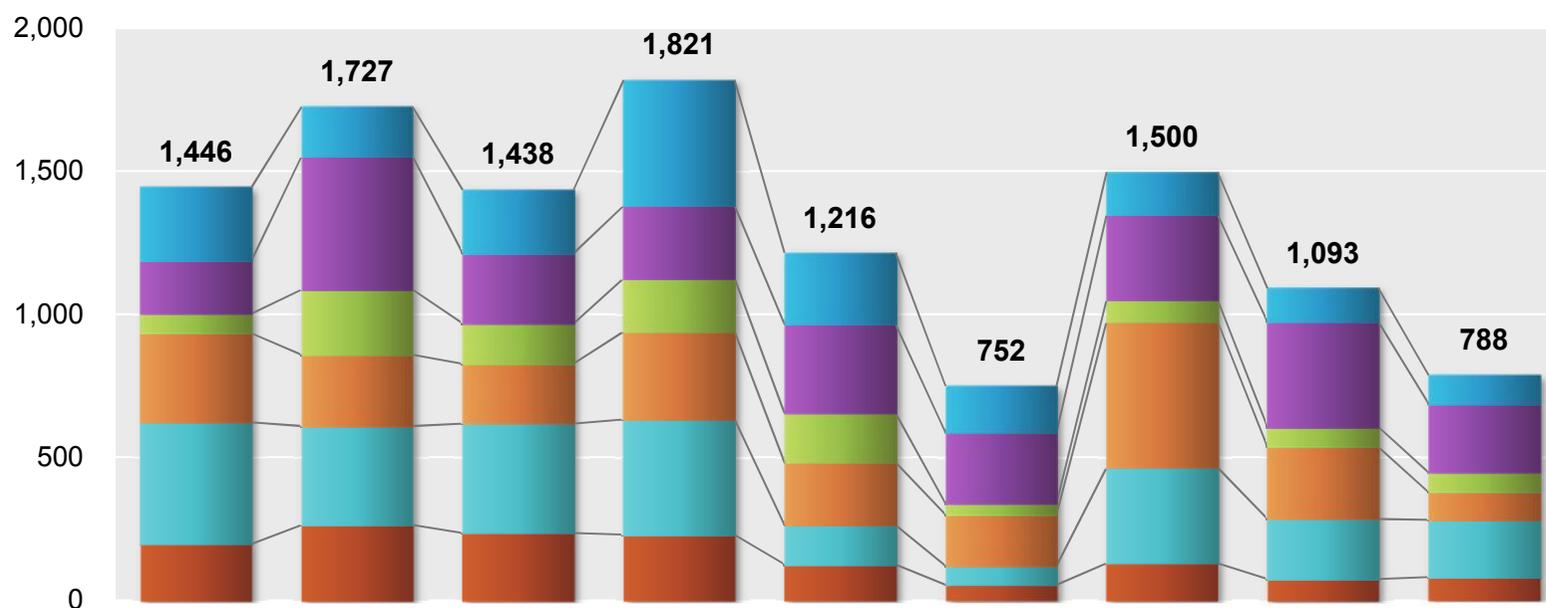
# 受注額・受注残高



|                | FY11/1Q | 2Q    | 3Q    | 4Q    | FY12/1Q | 2Q    | 3Q    | 4Q    | FY13/1Q |
|----------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 半導体製造装置受注額     | 1,332   | 1,502 | 1,286 | 1,558 | 1,126   | 735   | 1,449 | 1,064 | 760     |
| FPD/PV製造装置受注額  | 114     | 224   | 152   | 263   | 89      | 17    | 50    | 28    | 28      |
| 半導体製造装置受注残高    | 2,023   | 2,155 | 2,288 | 2,289 | 2,207   | 1,667 | 2,201 | 1,886 | 1,577   |
| FPD/PV製造装置受注残高 | 479     | 578   | 510   | 654   | 618     | 394   | 278   | 142   | 122     |

# 地域別受注額：SPE, FPD/PVE

(億円)

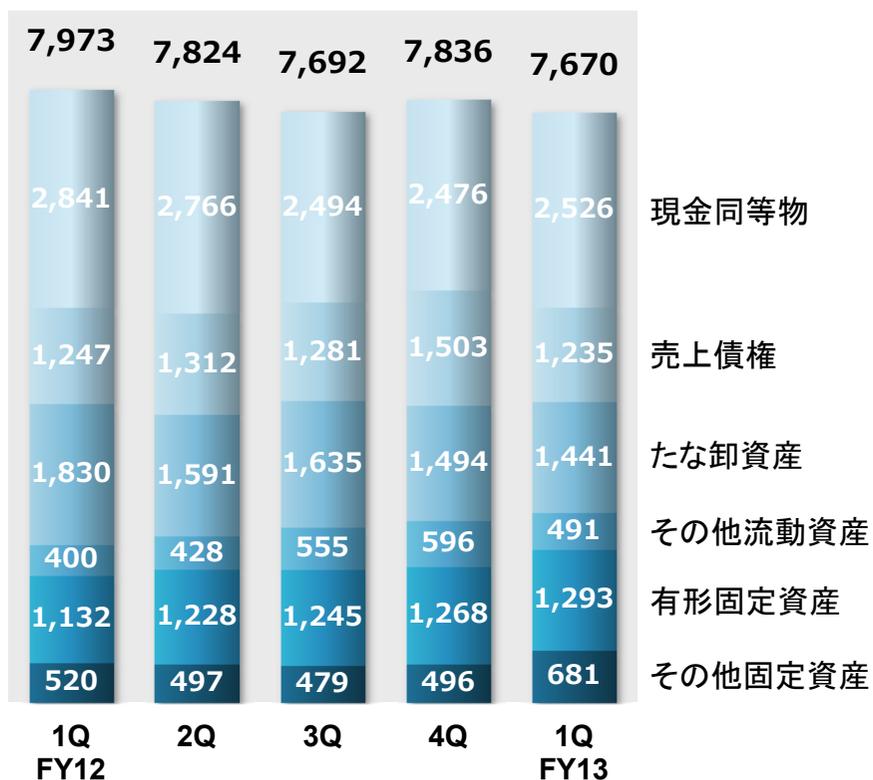


|         | FY11/1Q | 2Q  | 3Q  | 4Q  | FY12/1Q | 2Q  | 3Q  | 4Q  | FY13/1Q |
|---------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|
| 国内      | 256     | 173 | 222 | 439 | 250     | 163 | 149 | 117 | 100     |
| 米国      | 186     | 466 | 245 | 254 | 311     | 248 | 297 | 368 | 240     |
| 欧州      | 69      | 228 | 141 | 186 | 172     | 39  | 76  | 70  | 68      |
| 韓国      | 311     | 249 | 210 | 307 | 219     | 179 | 511 | 251 | 97      |
| 台湾      | 425     | 346 | 382 | 403 | 137     | 66  | 335 | 210 | 200     |
| 中国・東南ア他 | 197     | 263 | 235 | 229 | 125     | 54  | 129 | 74  | 81      |

# 貸借対照表

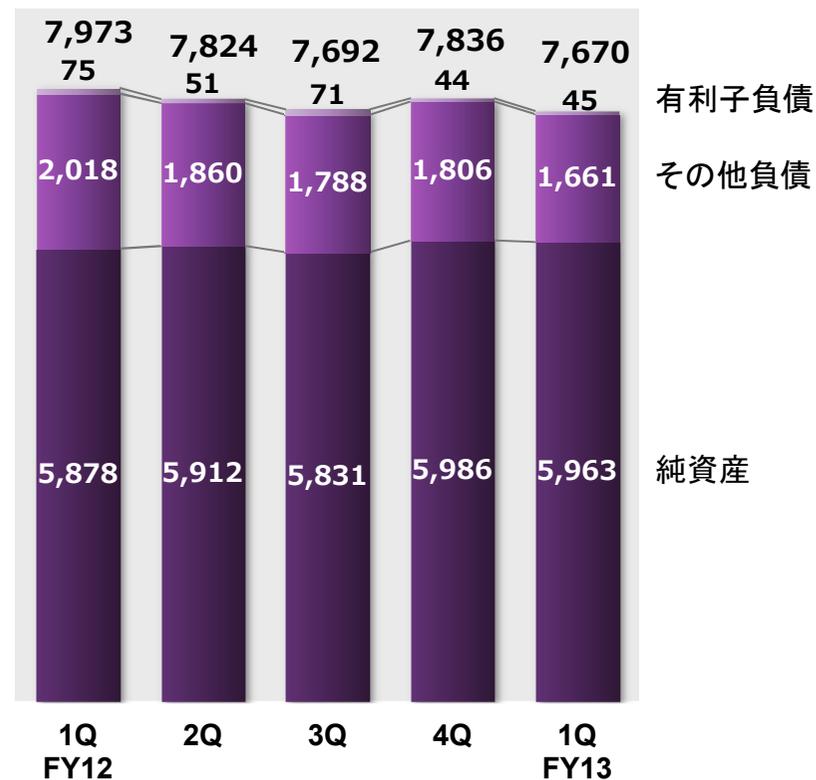
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

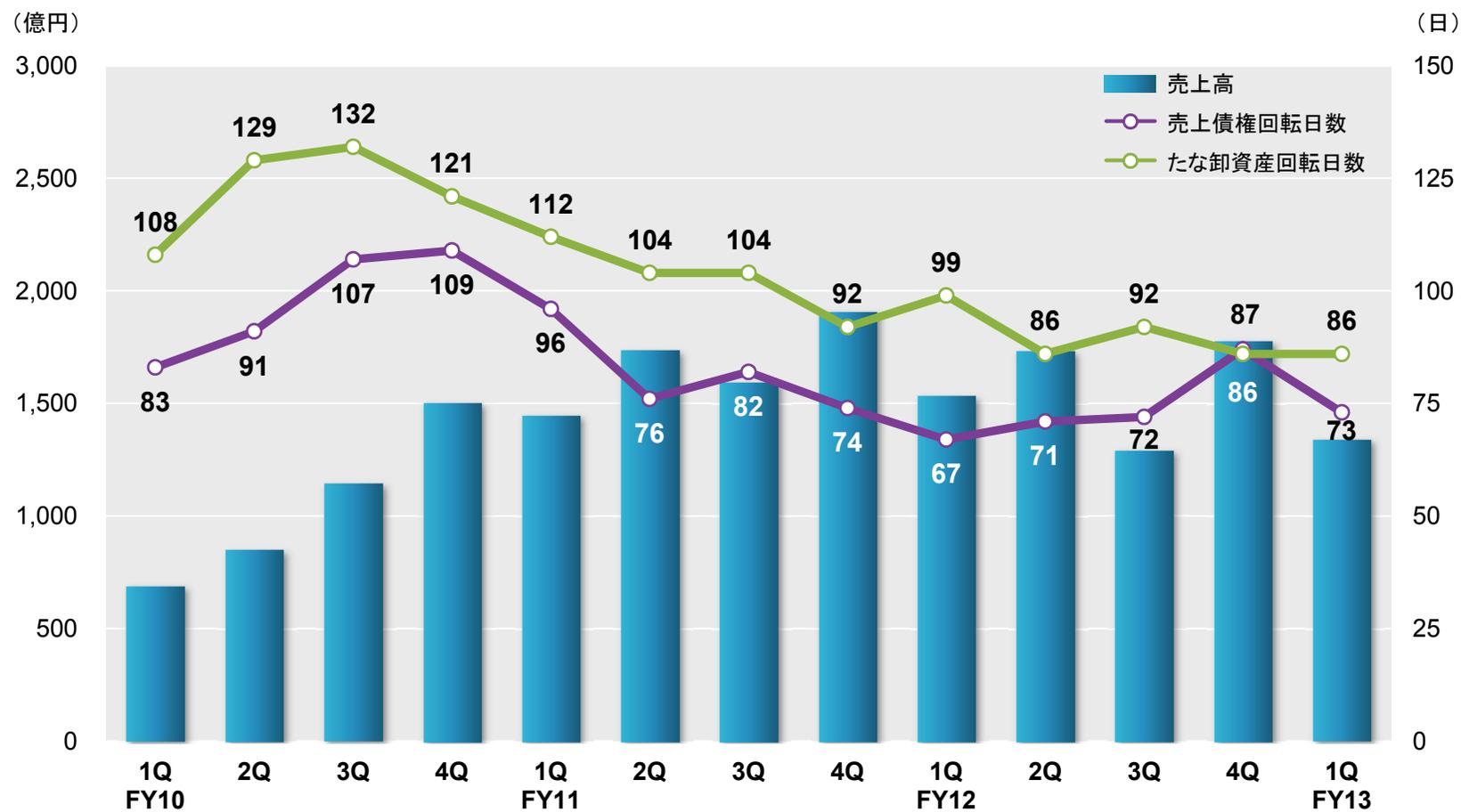
(億円)



1QFY13その他固定資産681億円には、企業買収等に伴うのれん155億円(暫定)が含まれています。

現金同等物: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は有価証券)

# たな卸資産・売上債権の回転日数



\* 回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

(億円)

|   | 2012年3月期 |       |       |       | 2013年3月期 |
|---|----------|-------|-------|-------|----------|
|   | 1Q       | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q       |
| 営業キャッシュ・フロー                             | 180      | 86    | -49   | 79    | 358      |
| 投資キャッシュ・フロー                             | -587     | -137  | 533   | 108   | -460     |
| 企業買収に伴う<br>株式取得による支出                    | -        | -     | -     | -     | -158     |
| 設備投資他                                   | -47      | -122  | -141  | -81   | -92      |
| 3か月超の預金等の増減額                            | -540     | -14   | 674   | 190   | -210     |
| 財務キャッシュ・フロー                             | -142     | -25   | -77   | -28   | -48      |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高                      | 1,101    | 1,011 | 1,414 | 1,587 | 1,428    |
| 現金及び現金同等物＋<br>3か月超の定期預金及び<br>短期投資等の期末残高 | 2,841    | 2,766 | 2,494 | 2,476 | 2,526    |

# 事業環境と2013年3月期業績予想修正

---

代表取締役社長 竹中 博司

2012年7月30日

# 市場環境

## 事業環境 2012年7月時点での見方

---

### ▶ 半導体設備投資

牽引役であるスマートフォン需要が当初の期待を下回り、PCの伸びも低調。その結果、一部先端開発分野への投資はあるものの、全般的に弱い。

### ▶ FPD設備投資

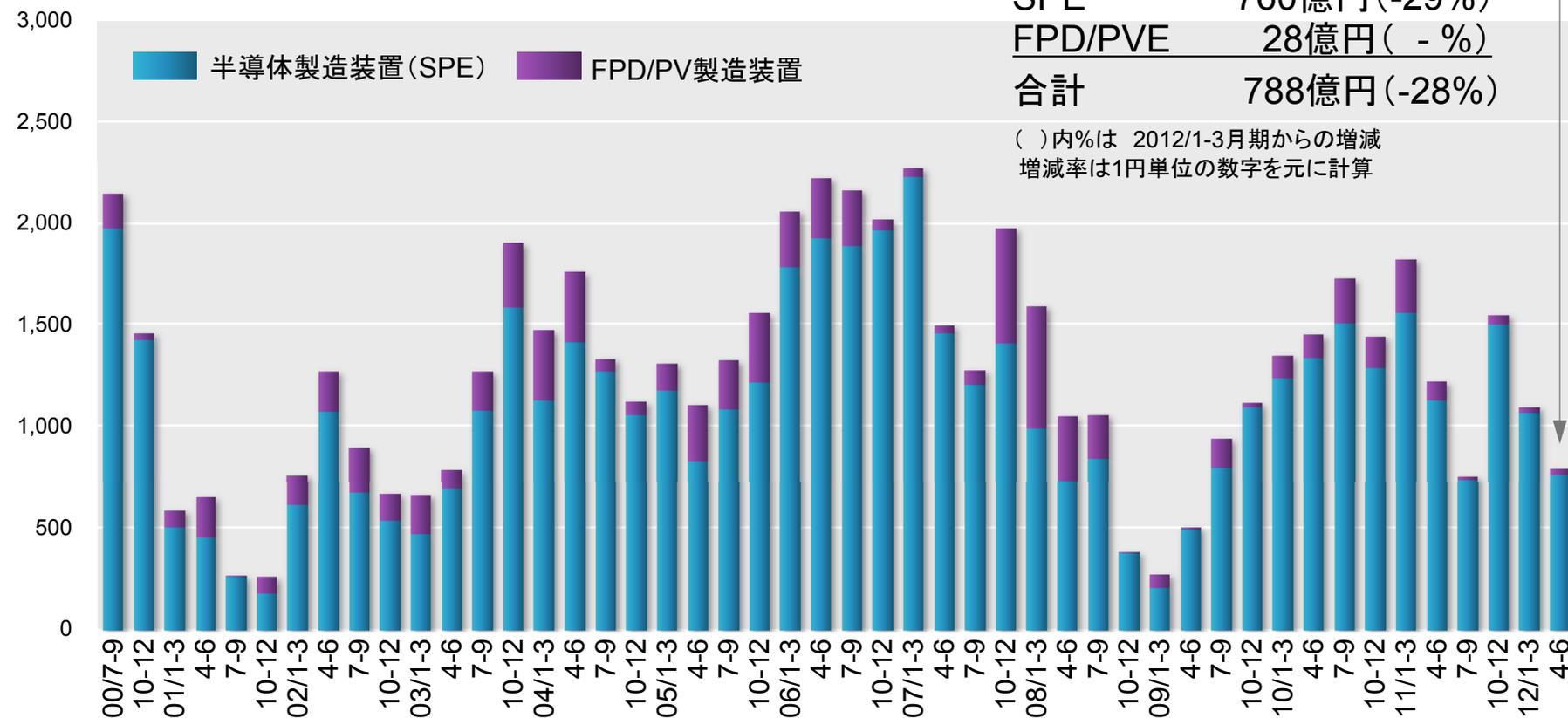
TV向け大型パネル市場の低迷により、大型液晶パネル用製造装置の需要は依然低調であるが、中小型向け需要は今後も拡大基調。

### ▶ PV設備投資

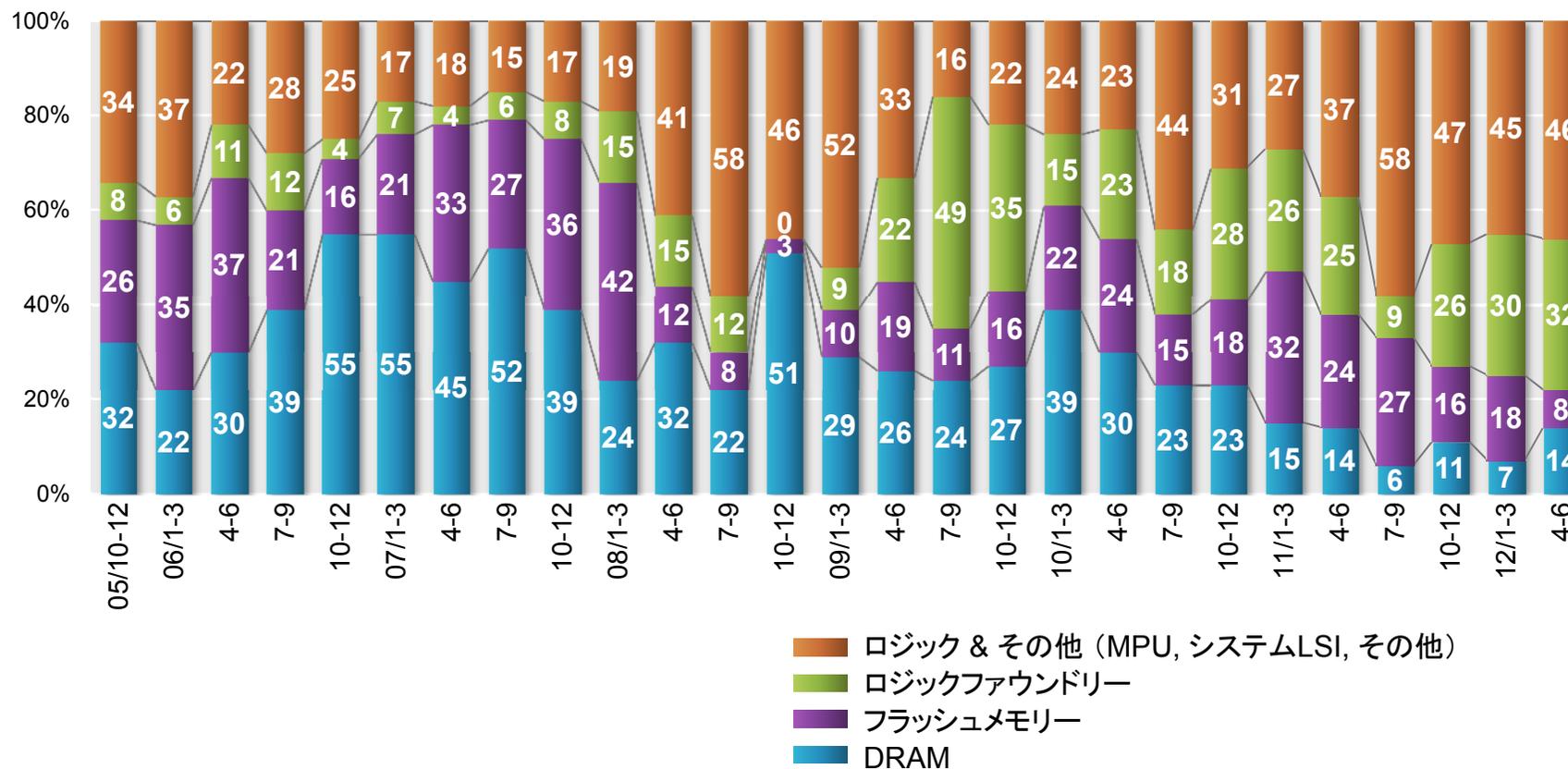
中長期的には引き続き成長が期待されているが、過剰な生産能力に伴う価格下落により、足元での設備投資は低迷。

# 四半期 受注額

(億円)



# 四半期 アプリケーション別SPE受注



- ロジック & その他 (MPU, システムLSI, その他)
- ロジックファウンドリー
- フラッシュメモリー
- DRAM

グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

# 半導体設備投資の今後の見通し

2012年

- ▶ 世界経済成長は全体的に減速傾向  
欧州悪化、中国軟化
- ▶ 想定より弱い電子機器市場  
PC, スマートフォン
- ▶ NANDが生産調整へ

足元、NAND及びファウンドリーの投資が減速

NANDの在庫調整終了、需給バランス改善

2013年

- ▶ モバイル機器が需要を牽引
- ▶ NAND量産投資再開
- ▶ ファウンドリー32/28nm投資本格化
- ▶ ファウンドリー20nm投資開始

# 幅広い製品群が半導体需要を牽引



新タイプの機器も登場、半導体搭載容量が増加する

---

# 2013年3月期業績予想修正



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 30, 2012



# 2013年3月期 業績予想修正

(億円)

|           | FY2012       | FY2013       |         |              |         |              |         |                 |
|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|
|           |              | 上期           |         | 下期           |         | 通期           |         | 通期<br>対前年<br>増減 |
|           |              | 新予想          | 修正額*    | 新予想          | 修正額*    | 新予想          | 修正額*    |                 |
| 売上高       | <b>6,330</b> | <b>2,680</b> | -70     | <b>2,620</b> | -530    | <b>5,300</b> | -600    | <b>-16%</b>     |
| SPE       | 4,778        | 2,160        | -70     | 2,000        | -510    | 4,160        | -580    | -13%            |
| FPD/PVE   | 698          | 90           | -       | 90           | -20     | 180          | -20     | -74%            |
| EC/CN     | 848          | 430          | -       | 530          | -       | 960          | -       | +13%            |
| その他       | 4            | -            | -       | -            | -       | -            | -       | -               |
| 営業利益      | <b>604</b>   | <b>95</b>    | -30     | <b>105</b>   | -240    | <b>200</b>   | -270    | <b>-404</b>     |
| 下段: 営業利益率 | <b>9.5%</b>  | <b>3.5%</b>  | -1.0pts | <b>4.0%</b>  | -7.0pts | <b>3.8%</b>  | -4.2pts | <b>-5.7pts</b>  |
| 税前利益      | <b>606</b>   | <b>125</b>   | -       | <b>130</b>   | -225    | <b>255</b>   | -225    | <b>-351</b>     |
| 当期純利益     | <b>367</b>   | <b>60</b>    | -14     | <b>80</b>    | -146    | <b>140</b>   | -160    | <b>-227</b>     |

\*修正額: 4/27に発表した業績予想からの修正額を示しています。

## 市場環境の変化でSPE売上が減速、業績予想を下方修正

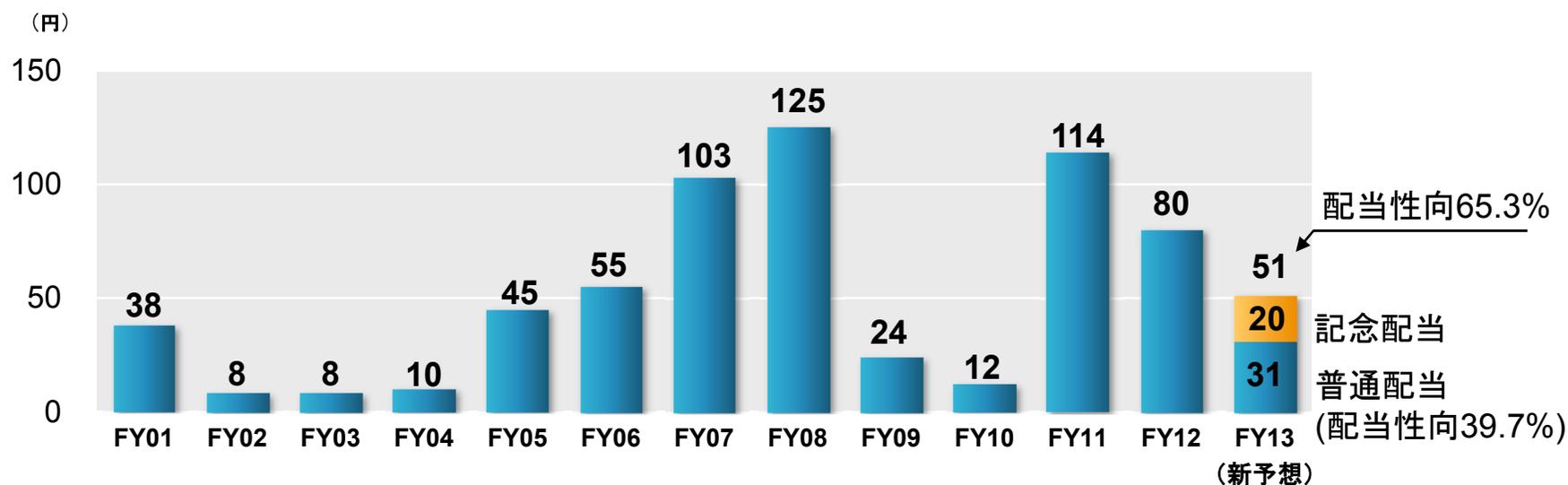
SPE: 半導体製造装置 FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

20

# 当期配当予想修正

| 1株当たり配当金 (予想) |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
|               | 中間配当 | 期末配当 | 合計  |
| 旧予想 (4/27)    | 25円  | 55円  | 80円 |
| 新予想           | 25円  | 26円  | 51円 |

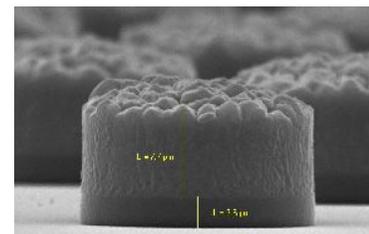
上記配当には、創立50周年記念配当20円(中間期10円、期末10円)を含みます。



FY2011の期末配当より、業績連動配当性向を従来の20%目途から35%目途に引き上げました。

# 米国 NEXX Systems社の買収完了 2012年5月1日

- ▶ 新社名：TEL NEXX, Inc.
- ▶ 取得対価：158億円
- ▶ 獲得技術：先端パッケージング用成膜技術
  - 電解めっき (ECD)
  - PVD



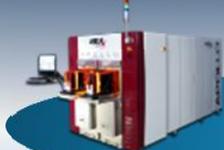
マイクロバンプ構造の積層めっき



高アスペクト比TSVへのCu埋め込み

## TELの先端パッケージング用製品ラインアップ

**NEXXプロダクト**

|   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| <br><b>Synapse™ V</b><br>Wafer bonder | <br><b>CLEAN TRACK™</b><br><b>LITHIUS™ Pro</b><br>Patterning | <br><b>Tactras™ FAVIAS™</b><br>Deep Si etcher | <br><b>CELLESTA™+</b><br>Cleaning | <br><b>TELINDY PLUS™VDP</b><br>Dielectric liner deposition | <br><b>Apollo</b><br>Physical Vapor Deposition | <br><b>Stratus</b><br>Electrochemical Deposition | <br><b>Synapse™ Z</b><br>Wafer de-bonder |
|---|--|---|--|--|--|--|--|

# サマリー

---

1. モバイル機器、PCの伸びが期初想定よりも低下傾向にあり、NAND及びファウンドリー投資が減速
2. 市場環境の変化を受けSPE売上が期初想定レベルに届かず、業績予想を下方修正
3. 調整局面での影響を精査し、適切なコスト水準に引き下げる

---

## ▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

## ▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

## ▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽電池

